



殿

仕様書

仕様書No.NWSP26-DNSBIDI-01A

環境対応
BIDI化モジュール
DNSBIDI

2026年 7月

1. 適用範囲

本仕様書は環境対応BIDI化モジュール(DNSBIDI)について規定します。

本仕様に関しては改良等の理由で変更する可能性があります。

2. 機能概要

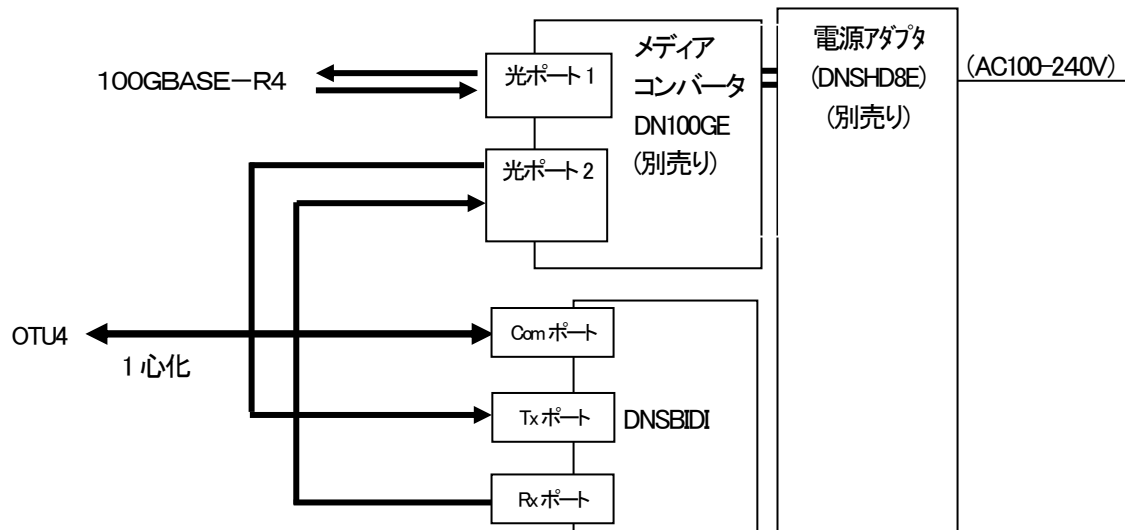
本装置は2心伝送路を1心化することができるBIDI化モジュールです。

本装置は別売のMC用サブラック(DNSHD8E等)を用いることで19インチラックに最大8台収納することが可能となります。

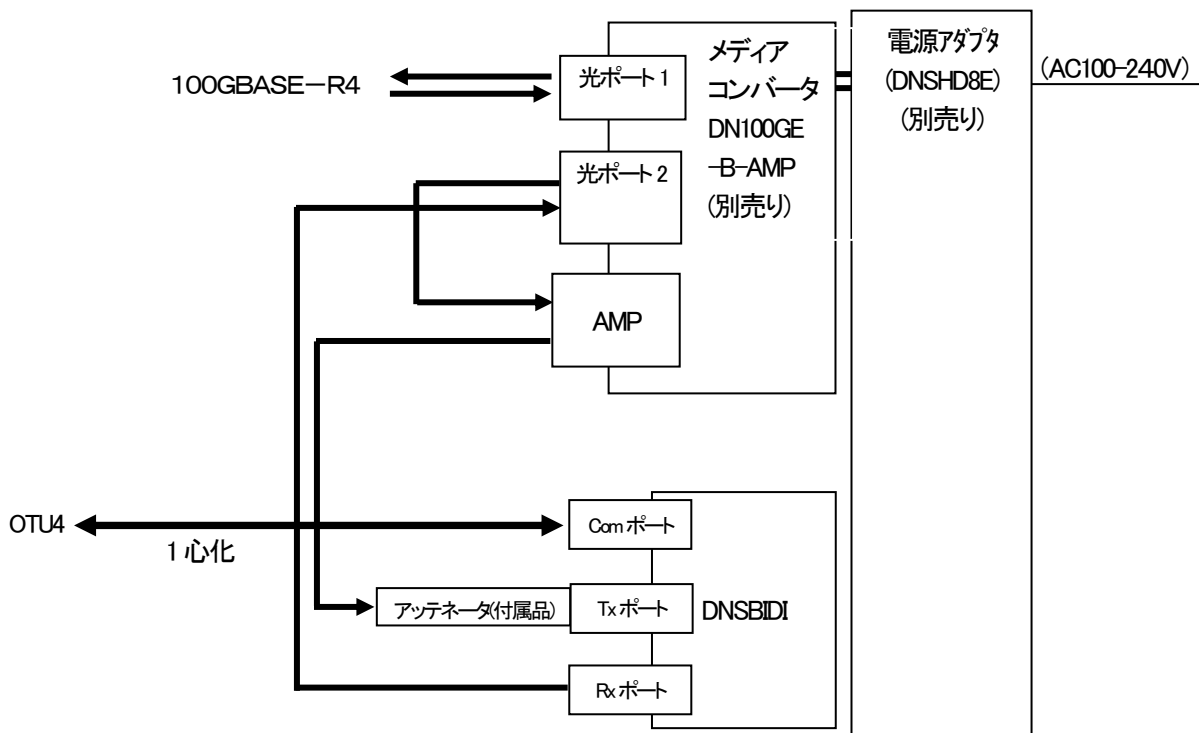
また、添付の取付金具にて固定も可能です。

(製品の構成例)

[DN100GE(AMPオプションなし)との接続例]



[DN100GE-B-AMP(AMPオプションあり)との接続例]



3. 品名及び型番

品名と型番は次のとおりとします。

品 名	型番
環境対応光BIDI化モジュール	DNSBIDI*

*: 電源は不要です。

本製品と接続可能な当社製品は以下の通りです。

	型番
環境対応100Gメディアコンバータ	DN100GE
	DN100GE-B-AMP

4. 仕 様

(装置仕様)

環 境 条 件	保 証 温 度	-5℃ ～ 60℃
	動 作 及 び 保 存 湿 度	95%RH以下(但し、結露なきこと)
	保 存 温 度	-40℃ ～ 85℃
構 造	外 形 寸 法	W51.2mm×H41.7mm×D180.0mm (突起部除く)
	質 量	180g以下 (本体のみ)

(仕様細目)

型 番	DNSBIDI(※1)(※2)
ポ ー ト 構 成	Tx, Rx, Com
通 過 中 心 波 長	1528.77nm～1567.13nm
リ タ ー ン ロ ス	50dB以上
デ ィ レ ク テ ィ ビ テ ィ	45dB以上
適 合 光 フ ァ イ バ	石英系シングルモード131μm帯ゼロ分散型光ファイバ(※3)
適 用 コ ネ ク タ	LCコネクタ(IEC61754-20)
研 磨 方 法 (※4)	SPC, AdPC, UPC研磨
挿 入 損 失	Txポート→COMポート間: 10dB 以下 COMポート→Rxポート間: 10dB 以下
ア イ ソ レ ー シ ョ ン	COM→Tx: 42dB 以上 Rx→COM: 42dB 以上
付 属 品	取付金具(2個)、取付金具固定用M3ねじ(4本)、治具(1個)、 2dB用固定アッテネータ(1個)(※5)
色 相	DIC621(相当色)
ケ ー ス 材 質	アルミ
環 境 特 性	RoHS2対応(※6)

※1:「Txポートに光信号を入射した状態でComポート部の挿抜」または、「Txポートに光信号を入射した状態で対向側BIDI化モジュールのTxポート部の挿抜」を行うと反射が発生しますが、Rev.B以降のDN100GEまたはDN100GE-B-AMPをラックオプション(DNSHD8EまたはDNSHD2)に実装し、ラックオプションに搭載されているMGTモジュールのファームウェアバージョンがV2.1.0以降であれば自動的に反射を検知し、自動復帰可能です。設定の詳細に関してはラックオプションの取扱説明書を参照下さい。

DN100GEまたはDN100GE-B-AMPがRev.AまたはラックオプションのファームウェアバージョンがV2.1.0以前の場合、自動検知機能、自動復帰機能はありません。そのため、反射が発生した際、正常にリンクアップしない場合があります。反射によりリンクアップしない場合は、DN100GEまたはDN100GE-B-AMPにリセットをかけるか、Rxポートの挿抜を実施して下さい。取扱説明書に推奨接続手順・取外手順・反射発生時の復帰操作方法を記載していますので参照下さい。

なお、Comポート部または対向側BIDIのTxポート部の挿抜を行う際は、DN100GE又はDN100GE-B-AMPを電源OFF状態にするかRxポートを未接続状態にすることで反射を未然に防ぐことができます。

※2:アンプオプション品(DN100GE-B-AMP)と接続する場合は下記内容をご確認の上、ご使用下さい。

- ・1心化の部分(COM-COM間)のJJコネクタによるファイバの接続点が増えると、正常にリンクアップしない場合があります。
- ・1心化の部分(COM-COM間)にアッテネータ等のロスを接続しないで下さい。
- ・各対向の「AMP出力部-BIDI Txポート部」は、極力同等の長さの光ファイバにて接続して下さい。各対向のBIDI Txポート部に入力する光パワーに差が生じると、リンクアップしない場合があります。

※3:分散シフトファイバ(DSF)を使用することができます。分散シフトファイバを使用する場合には、挿入損失の特性値が異なりますのでお問い合わせ下さい。

※4:PC、APC(斜め)研磨には対応していません。

※5:アンプオプション品(DN100GE-B-AMP)と接続する場合は、本アッテネータを本装置のTxポートに装着してご使用下さい。
アッテネータの爪が折れたものは、通信品質に影響を及ぼす可能性があるため、使用しないで下さい。

※6:表1に示す化学物質については下記の通り管理致します。

表1. RoHS2規制物質及び閾値の概要

化学物質群名	用途または対象	閾値(質量比)
カドミウム及びその化合物	包装材以外(*1)	100ppm
鉛及びその化合物(*2)	下記以外(*1)	1000ppm
	鋼材	3500ppm
	アルミニウム合金	4000ppm
	銅合金	40000ppm
水銀及びその化合物	包装材以外(*1)	1000ppm
六価クロム化合物	包装材以外(*1)	1000ppm
ポリ臭素化ビフェニル類(PBB)	全て	1000ppm
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE)	全て	1000ppm
フタル酸ジニエチルヘキシル類(DEHP)	全て	1000ppm
フタル酸ブチルベンジル類(BBP)	全て	1000ppm
フタル酸ジブチル類(DBP)	全て	1000ppm
フタル酸ジイソブチル類(DIBP)	全て	1000ppm

*1:包装材は、カドミウム・鉛・水銀・六価クロムの4重金属を合わせて100ppm以下です。

*2:電子部品中の内部接続用高融点半田、電子部品中のガラス、電子セラミックス部品などに含まれる鉛は対象外です。

5. 表示及び包装

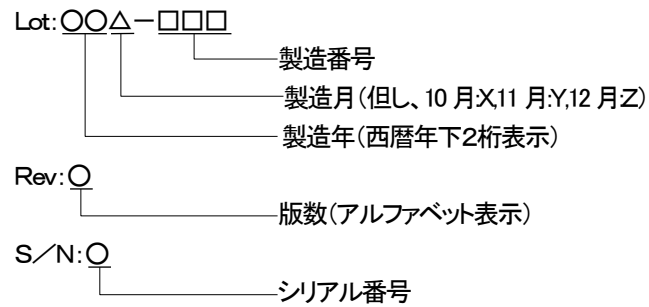
(1) 型番表示及びロットシール

本体には型番を表示します。

ロットシールには、型番、ロットNo、製造社名を表示します。

表示位置は外観図を参照下さい。

【ロットNo. 表示内容の説明】



(2) 包装

製品本体、付属品を個装段ボール(内箱)に包装し、個装段ボールは運搬中損傷しないよう適切な段ボールに包装します。

(3) 包装への表示

内箱には、型番、製造社名及び製品のロット番号を表示した内箱シールを貼付けます。

6. 保証

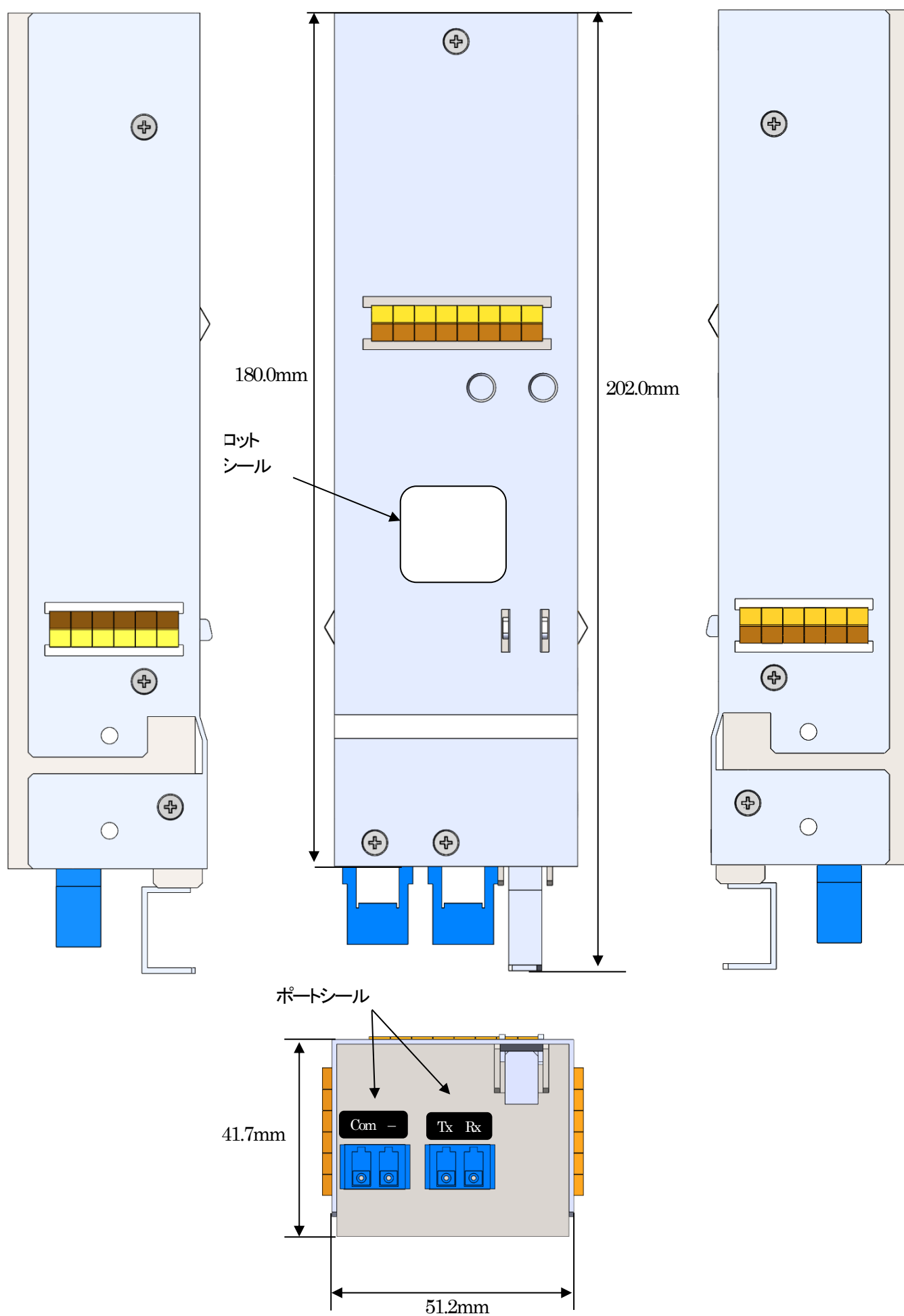
(保証内容)

保証期間内に設計製作上の不備により破損又は故障が発生した場合は、無償で交換を行うものとします。

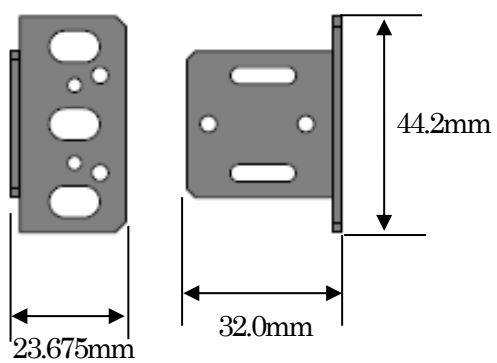
(保証期間)

当社出荷日起算から6年間

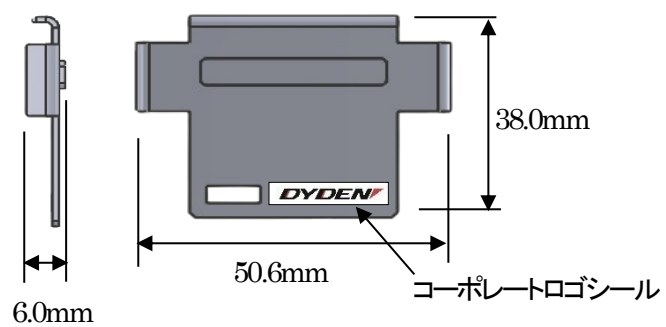
7. 外観及び寸法



[取付金具]



[治具]



以上

参考)シール表示

(1)ポートシール



(2)コーポレートロゴシール

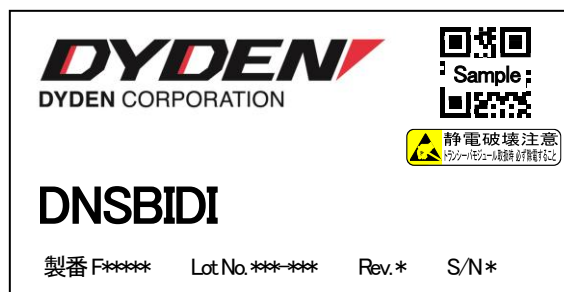


(3)型番/ロットシール
表示例)



型番/ロットシール

(4)内箱シール
表示例)



内箱シール

改版履歴

2026 年7月2日

版数	日付	改版内容
NWSP26-DNSBIDI-01	2026 年3月	・初版
NWSP26-DNSBIDI-01A	2026 年7月	・接続可能な製品を追加(DN100GE-B-AMP) ・反射対策を追記 ・型番/ロットシール変更 ・シール類の寸法表記削除